ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

MIRDC-105-A20R

全球半導體檢測設備關鍵技術與標竿廠商發展策略

作者：陳慧娟

執行單位：財團法人金屬工業研究發展中心

中華民國一〇五年十一月

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

目錄

■ 摘要 …… 1

■ 一、全球半導體檢測設備關鍵技術剖析 …… 2

■ 二、全球半導體檢測設備標竿廠商技術與發展策略 …… 6

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

全球半導體檢測設備關鍵技術與標竿廠商發展策略

金屬中心 MII 產業分析師 陳慧娟

摘要：

半導體檢測設備領域主要區分為：1.微距測試設備、2.光罩/網版檢查設備、3.晶圓表面檢查設備、4.晶圓外觀檢查設備、5.膜厚計、6.微粒子計數器、7.半導體測試設備、8.信賴性測試設備，各領域之相關類別如【表1】所示。台灣半導體設備市場前三大類別為：1.半導體測試設備(台灣市場規模為新台幣292.6億元)、2.晶圓表面檢查設備(台灣市場規模為新台幣174.7億元)、3.微距測試設備(台灣市場規模為新台幣43.5億元)。

美商科磊公司以全球市佔率72.8%在晶圓缺陷檢查設備市場獨佔鰲頭，日立先端科技公司以9.1%市佔率居次，第三為美商應用材料的6.9%。此外，美商科磊公司在晶圓形狀檢測設備擁有85%的壓倒性市佔率。在微距測試設備領域，90%以上是由日立先端科技公司與美商應用材料主導市場。

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

《全球半導體檢測設備關鍵技術與標竿廠商發展策略》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517
傳真 | 02-27329133
客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw
地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

匯款資訊 | 收款銀行：兆豐銀行南台北分行 (銀行代碼：017)
戶名：財團法人資訊工業策進會
收款帳號：39205104110018 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五
am 09:00-12:30 pm13:30-18:00

Industry & Technology Intelligence Services
經濟部技術處產業技術知識服務計畫

如欲下載此本產業報告電子檔，
請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。
ITIS 智網：http://www.itis.org.tw/

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)